

中信证券股份有限公司

关于贵州振华风光半导体股份有限公司

2022 年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“振华风光”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责振华风光上市后的持续督导工作，并出具 2022 年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与振华风光签订保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解振华风光业务情况，对振华风光开展了持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2022 年度振华风光在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2022 年度振华风光在持续督导期间未发生违法或违背承诺事项

序号	工作内容	实施情况
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	2022 年度，保荐机构督导振华风光及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促振华风光依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对振华风光的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，振华风光的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促振华风光严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对振华风光的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的问题事项
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2022 年度，振华风光及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2022 年度，振华风光及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况

序号	工作内容	实施情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2022 年度，经保荐机构核查，振华风光不存在应及时向上海证券交易所报告的问题事项
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： （一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2022 年度，振华风光未发生相关情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	2022 年度，振华风光不存在需要专项现场检查的情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司可能存在的相关风险如下：

（一）核心竞争力风险

1、研发未达预期风险

公司围绕市场需求，开展核心技术研发、新产品拓展、技术升级改造等工作，

投入了大量的资金和人力，公司对技术成果的产业化和市场化进程具有一定不确定性，如果在研发过程中关键技术未能突破、性能指标未达预期，或者研发出的产品未能得到市场认可，公司将面临前期的研发投入无法收回且难以实现预计效益的风险，并将对公司业绩产生不利影响。

2、研发人员不足或流失的风险

集成电路行业是技术密集型行业，关键技术和人才是公司保持持续竞争优势的基础，随着技术研发的深入，技术创新在深度和广度上都将会更加困难。这就需要公司在技术研发方面不断加大投入，同时加大对高端、复合型技术人才的引进。如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研发方面的持续投入，不能吸引和培养更加优秀的技术人才，或者出现研发人员流失的情况，都将会导致公司的竞争力下降。

（二）经营风险

1、客户集中度较高风险

报告期内，由于公司下游客户主要以中航工业集团、航天科技集团、航天科工集团、航发集团、兵器集团等国有军工集团的下属单位为主，使得公司以同一集团合并口径的客户集中度相对较高。虽然公司与主要客户形成了密切配合的合作关系，按照军品供应的体系，通常定型产品的供应商不会轻易更换，且公司积极研发满足现有客户需求的新产品、积极拓展新客户、开拓新市场，减少客户集中度高的潜在不利影响。但若公司在新业务领域开拓、新产品研发等方面进展不利，或现有客户需求大幅下降，则较高的客户集中度将对公司的经营产生影响。

2、税收政策变动的风险

国家一直以来重视集成电路企业的政策支持，公司作为高新技术企业，享受着国家税收政策优惠，但是未来若国家相关税收优惠政策发生变化，将会对公司经营业绩带来不利影响。

（三）财务风险

1、应收账款及应收票据余额较高的风险

报告期公司业务规模不断扩大，应收账款及应收票据的余额相应增长。公司主要产品应用于航空、航天、兵器、船舶等军工核心领域，由于集成电路处于军工武器装备产业链配套末端，配套产品验收程序严格和复杂，结算周期较长，同时受军工客户主要集中在年末付款且以商业承兑票据结算为主，导致公司销售回款速度慢，应收账款、应收票据规模较大。公司的下游客户主要为央企及其子公司，整体信誉较好，支付能力较强。但若公司不能有效提高应收票据及应收账款管理水平及保证回款进度，将有可能出现应收票据及应收账款持续增加、回款不及时甚至坏账的情形，从而对公司经营成果造成不利影响。

风险管理措施：针对公司业务的特点，公司在签订销售合同时将持续加强对合同签订方经营状况及信用的调查，合理制定客户的信用额度；进一步优化应收账款回款激励机制，加大应收账款的催收力度，并严格按照坏账计提政策计提坏账准备，全力降低应收账款不能回收的风险。

2、存货金额较大及发生减值风险

报告期随着公司业务规模的不断扩大，为满足生产经营需要，公司存货相应增加。受产品种类型号多、验收程序繁琐等因素的影响，公司储备的原材料较大，客户尚未验收的发出商品余额较大，导致存货余额较高。同时，公司积极应对客户的需求，提升生产灵活性，结合市场供需情况及预期客户的需求，对部分产品提前备货。若公司无法准确预测客户需求并管控好存货规模，将增加因存货周转率下降导致计提存货跌价准备的风险。

风险管理措施：一方面公司将坚持采用“以销定产、以产定购”的计划型采购模式，对存货规模进行严格控制，同时加强销售队伍建设，不断完善客户需求分析管理体系，合理备货；另一方面严格按照政策定期计提存货跌价准备，以减少存货跌价风险。

（四）行业风险

面对西方国家对我国经济发展的限制，很大程度阻碍了我国信息化、数字化水平的提升和发展，尤其是集成电路的应用范围极广，涉及到电力电网、核设施、航空航天、汽车电子、以及武器装备等国防安全核心领域，近年来也不断受到针

对我国集成电路产业颁布的一系列禁限措施影响，使得我国集成电路核心水平发展缓慢，芯片制造环节也长期处于“卡脖子”状态。公司作为高新集成电路企业，难免会受到行业波动的影响，若未来国外对我国集成电路行业继续实施限制和封锁，将有可能影响到公司的经营业绩。

四、重大违规事项

2022 年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

（一）主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	77,887.40	50,232.77	55.05
归属于上市公司股东的净利润	30,301.82	17,692.43	71.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,236.43	17,835.86	63.92
经营活动产生的现金流量净额	-22,586.75	-2,096.33	不适用
主要会计数据	2022 年末	2021 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	419,387.19	61,910.27	577.41
总资产	481,673.53	126,943.92	279.44

（二）主要财务指标

主要财务指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元 / 股）	1.8181	1.1795	54.14
稀释每股收益（元 / 股）	1.8181	1.1795	54.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.7542	1.1891	47.52
加权平均净资产收益率（%）	16.32	35.70	减少 19.38 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.74	35.98	减少 20.24 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	11.31	9.30	增加 2.01 个百分点

（三）主要会计数据和财务指标的说明

1、2022 年度营业收入同比增长 55.05%，主要系国内高可靠集成电路市场持续向好，公司聚焦技术创新，发挥核心产品竞争优势，产品销量实现增长，销售订单快速增长；

2、2022 年归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别同比增长 71.27%及 63.92%，主要系 2022 年度营业利润增加所致；

3、基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益分别同比增长 54.14%、54.14%及 47.52%，主要系报告期内营业收入大幅上升，净利润增加、盈利能力提升所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）核心竞争力分析

1、研发技术优势

公司致力于集成电路的设计以及相关技术的开发，高度重视研发投入和技术创新，公司在报告期内，成立了西安、南京研发中心，建成了近两百人的集成电路专业设计团队。截止 2022 年末，累计授权发明专利 21 件、实用新型专利 60 件、集成电路布图设计登记 96 件，结合其他非专利技术形成了多项核心技术，构成了完善的自主研发体系。公司在放大器、轴角转换器等产品设计、封装、测试方面掌握多项核心技术，通过不断竞标及研发一系列项目，产品种类不断扩展。在放大器领域，突破了失调电压温度负载稳定性技术、nV 级超低噪声设计技术等核心技术，形成了精密型、高速型、通用型等 5 大类体系产品。在接口驱动领域，突破了 fA 级超低漏电模拟开关设计技术、多通道电阻匹配设计技术、±3.5KV 高压 ESD 接口设计技术等核心技术，形成了模拟开关、接口收发器、驱动器等体系产品。在电源管理领域，突破了高精度低噪声电压基准源设计技术、高阶温度补偿及多位修调技术、超低温漂基准源设计技术等核心技术，形成了电压基准源、三端稳压源、PWM 等体系产品。在轴角转换器领域，突破了 RDC 数字化算法设计技术、霍尔传感器灵敏放大器设计技术、双向多级嵌套快速数字复合修调技术等核心技术，形成了有刷轴角转换器、无刷磁编码器、数据采集器 DAS

等体系产品。在系统封装集成电路领域，突破了三维多基板堆叠封装技术、高可靠异质界面同质化技术等核心技术。产品应用涵盖各军兵种，为集成电路国产化做出了贡献。封装技术方面，形成了陶瓷、金属、塑封三大类 60 多个型号的高可靠封装，技术上覆盖第一代直插式、第二代表贴式和第三代阵列式封装，具备高密度、细间距、薄型化、小型化封装能力，在国内处于先进水平。检测技术方面，按国军标要求，建立了完善的电性能测试、机械试验、环境试验等检测条件，在国内处于领先地位。曾多次获得贵州省、中国电子科的科技进步奖，国家级专精特新“小巨人”企业等荣誉。公司持续加大研发投入，为产品迭代及拓展谱系提供充分的保障。

2、供应链优势

公司具备完整的集成电路芯片设计、封装与测试能力，晶圆制造主要采用外协加工的形式，已和业内主流的晶圆代工企业、原材料供应商建立长期合作伙伴关系，为公司的产能提供有效保障。公司对原材料供应商的工艺经验、技术水平、商业信用进行严格考核，注重国产原材料的应用，与国内主流的高可靠集成电路原材料供应商建立了稳定的合作关系。有力地保障了原材料供应水平的持续提升。

3、品牌和客户资源丰富

公司是国内率先实现模拟集成电路批量生产的厂商之一。公司始终围绕信号链和电源管理器等产品进行设计开发，产品主要包括放大器、轴角转换器、接口驱动、系统封装集成电路、电源管理等类别，型号数量近 200 余款，其中放大器、轴角转换器在行业内占据重要地位，与同行业公司相比具有明显竞争优势；通过多年的市场耕耘，公司与客户建立了长期稳定的合作关系，涉及航空、航天、兵器、船舶、电子、核工业等各领域客户近 500 家。公司多次获得航空、航天、兵器、电子系统下多家单位的优秀供应商、金牌供应商称号。

4、产品配套齐全

公司多年来从事高可靠集成电路的研制，放大器作为公司主要研发方向，产品覆盖通用、精密、高速、功率、仪表等放大器，公司产品包括轴角转换器、

接口驱动、系统封装集成电路、电源管理等，2022 年新增磁编码转换器、数字隔离器等，应用范围覆盖航空、航天、兵器、船舶、电子、核工业等相关领域。公司产品门类丰富，种类齐全，可靠性高，有近 200 款产品已经实现批量供货，具有较强的产品配套能力。

5、人才优势

公司拥有集成电路行业内优秀的技术、研发和管理团队，在模拟、混合集成电路的设计和产业化方面积累了丰富的丰富经验，并在“贵阳+成都”基础上，在西安、南京建立研发中心，为公司可持续发展提供了有力保障。报告期末，公司研发人员占比 25.2%（其中硕士及以上学历研发人员占比 28.7%），为公司产品保持先进性提供必要条件。同时，公司通过创新人才激励机制和更加灵活的政策，吸引和激励优秀人才与公司共同发展。

（二）报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

不适用。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	变化幅度（%）
费用化研发投入	8,809.06	4,673.72	88.48
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	8,809.06	4,673.72	88.48
研发投入总额占营业收入比例（%）	11.31	9.30	增加 2.01 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

报告期内研发费用总额为 8,809.06 万元，增长 88.48%，主要原因系公司加大产品研发投入，扩大了研发团队规模，新增西安研发中心、南京研发中心所致。

（二）研发进展

报告期内，公司在推进模拟集成电路自主研制中取得了一定的成果，以电机驱动系列为例，通过中国电子信息产业集团有限公司组织的科学技术成果鉴定。

该产品在基于高阶温度补偿、高可靠 ESD MOS 器件结构进行设计创新，取得授权发明专利 1 件、实用新型专利 2 件，经成果鉴定，产品技术达到国内领先水平。

报告期内，公司在集成电路设计领域，申请发明专利 12 件、实用新型专利 10 件、集成电路布图设计 20 件；在集成电路封测领域，申请发明专利 4 件、实用新型专利 11 件。

专利类型	2022 年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	16	3	67	21
实用新型专利	21	9	84	60
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	0	0
其他	20	25	114	96
合计	57	37	265	177

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 66.99 元。募集资金总额为人民币 3,349,500,000.00 元，扣除全部发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 3,259,923,588.89 元。上述募集资金已全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，于 2022 年 8 月 23 日出具了《验资报告》（中天运〔2022〕验字第 90043 号）。

2、募集资金使用及结余情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 636,659,050.00 元，加上募集资金专用账户扣除手续费后累计利息收入净额后，募集资金余额为 2,628,633,760.81 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	3,259,923,588.89
减：募集资金项目的支出	19,659,050.00
减：永久补充流动资金的金额	617,000,000.00
加：扣除手续费后累计利息收入净额等	5,369,221.92
募集资金余额	2,628,633,760.81

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

序号	开户银行名称	银行账号	存款方式	余额	募集资金用途
1	中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行	52050152373609000888	活期存款	936,518,385.17	高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目募集资金
2	招商银行股份有限公司贵阳分行营业部	7555916511810502	活期存款	245,670,157.60	研发中心建设项目募集资金
3	中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040021762	活期存款	826,693,338.64	超募资金
4	中国工商银行股份有限公司贵阳新添支行	2402006429200068732	活期存款	619,751,879.40	超募资金
合计				2,628,633,760.81	

（二）募集资金使用是否合规

公司 2022 年募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集

资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股股东为中国振华电子集团有限公司，持有公司 40.12%的股份。公司实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司，其通过持有中国电子有限公司与中国振华股权间接控制振华风光 40.12%的股份，并通过中电金投间接控制振华风光 2.92%的股份，合计控制振华风光 43.04%的股份。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未直接持有公司股票，通过员工持股平台（风光智、风光芯）、中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股票情况如下：

序号	姓名	任职情况	间接持股情况	减持情况	质押或冻结情况
1	张国荣	董事长	持有风光芯 6.04%的出资份额，通过中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 7.64%的份额	无减持	无质押或冻结
2	赵晓辉	董事兼总经理	持有风光智 5.44%的出资份额，通过中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 10.01%的份额	无减持	无质押或冻结
3	刘宗永	党委副书记、纪委书记、总法律顾问、工会主席	持有风光芯 4.83%的出资份额，通过中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 5.18%的份额	无减持	无质押或冻结
4	刘岗岗	副总经理	持有风光芯 4.83%的出资份额，通过中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 5.86%的份额	无减持	无质押或冻结
5	唐拓	副总经理	持有风光智 4.35%的出资份额，通过中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	无减持	无质押或冻结

			参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 5.86%的份额		
6	胡锐	副总经理、董事会秘书、核心技术人员	持有风光智 4.35%的出资份额，通过中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 5.86%的份额	无减持	无质押或冻结
7	王德成 (离任)	副总经理	持有风光智 4.35%的出资份额，通过中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 5.18%的份额	无减持	无质押或冻结
8	刘健	副总经理	持有风光芯 4.83%的出资份额，通过中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 5.58%的份额	无减持	无质押或冻结
9	孟利云 (离任)	总会计师	持有风光智 4.35%的出资份额，通过中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 3.41%的份额	无减持	无质押或冻结
10	李政	核心技术人员	持有风光智 2.31%的出资份额，通过中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 2.54%的份额	无减持	无质押或冻结
11	李平	核心技术人员	持有风光智 1.73%的出资份额，通过中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 2.80%的份额	无减持	无质押或冻结
12	唐毓尚	核心技术人员	持有风光智 3.27%的出资份额，通过中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 2.52%的份额	无减持	无质押或冻结
13	夏良	核心技术人员	持有风光智 1.16%的出资份额，通过中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 2.52%的份额	无减持	无质押或冻结
14	李雪	核心技术人员	持有风光智 1.16%的出资份额，通过中信证券振华风光员工参与科	无减持	无质押或冻结

			科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 2.80%的份额		
--	--	--	---	--	--

注：截至 2022 年 12 月 31 日，风光智直接持有公司股份 3,869,867 股，风光芯直接持有公司股份 3,486,239 股，中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划直接持有 3,713,333 股。

除上表列示以外，公司其余董事、监事和高级管理人员未直接或间接持有公司股票。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员直接和间接持有的振华风光股份不存在质押、冻结及减持的情形。

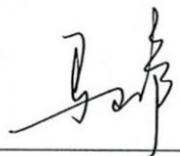
十一、保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于贵州振华风光半导体股份有限公司 2022 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人:



马 峥



王 彬

